軟磁性コンパウンド

射出成形用 EMCコンパウンド

成形品イメージ

概要

射出成形用EMCコンパウンドは、戸田工業のソフトフェライト粉末や軟磁性メタル粉末をPPSやPAなどの樹脂と混合させた軟磁性モールド材です。優れた磁気特性と射出成形性を両立しており、複雑な形状のインダクターコアや構造体、各種EMC機能(漏洩磁界低減・磁気シールド)を有した部品や筐体の設計が可能です。

特徴

高透磁率	磁性粉末を高充填させることができるため、優れた透磁率特性が得られます。
優れた射出成形性	樹脂複合化に適した特性を有する磁性粉末を使用しており、成形性に優れています。
ニーズに合わせた樹脂選定	車載用途に使われるエンプラやスーパーエンプラなど各種樹脂のコンパウンドも可能です。

製品情報

【代表製品の特性】

銘柄	樹脂	磁性粉(フィラー)	成形密度	流動性MFR	透磁率μ' at 10MHz	磁束密度B	荷重たわみ温度※	曲げ強度	衝撃強度	線膨張係数
			ASTM-D792	ASTM-D1238	-	-	ISO 75-2	ASTM-D790	ASTM-D256	JIS K 7197
			(g/cm^3)	(g/10min)	(-)	(mT)	(℃)	(MPa)	(kJ/m^2)	(×10^{-5}/℃)
SP-I247AEN	PA12	鉄粉	5.0	400 [270℃/5kgf]	10.5	1,220	112	60	9	6.6
MC100LK31	PA6	Mn-Mg-Zn フェライト	3.3	55 [270℃/10kgf]	16.5	160	172	120	6	4.1
SP-N736	PPS	Ni-Zn フェライト	3.6	40 [300℃/5kgf]	16.4	250	215	95	5	2.2

※方向：フラットワイズ、曲げ応力：1.80MPa

用途

- インダクターコア、構造体
- 電磁波吸収・磁気シールド・ノイズ抑制用途の部品・筐体

戸田工業株式会社　東京オフィス

〒108-0014　東京都港区芝5丁目13-15　芝三田森ビル6階　　Tel 03-5439-6040　　E-mail: webmaster@todakogyo.co.jp

本資料に記載したデータは保証値ではありません。また記載内容については、改良などの事由により予告なく変更する場合があります。

Ver. May 2024